

平成 23 年 7 月 21 日

長瀬産業株式会社

## 半導体材料事業への取り組み強化に関するお知らせ

～新組織体制で実装開発、材料に注力～

長瀬産業株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:長瀬洋)は、この度新組織体制として電子化学品事業部 半導体材料部 を設置し、半導体前工程/後工程の各種材料、加工事業を半導体材料部に一元化し、半導体材料事業への取り組みを強化することとなりましたのでお知らせいたします。

### <半導体事業について>

当社グループでは従来より半導体市場向けに様々な製品、ソリューションを提供してきました。その様々な製品の開発、生産を行ってきた当社 100%子会社のナガセケムテックス株式会社(本社:大阪市西区、代表取締役社長:毛利充邦)の播磨事業所にて、新たに半導体後工程事業としてウェハーバンピング※サービスを開始、今後ますます期待されるマイクロ実装向けのはんだバンブ加工を中心に、エレクトロニクス業界で採用が進むマイクロバンブ事業をより推進して参ります。

※ウェハーバンピングとは…

ベアチップと実装基板を接続する際に使用されるバンブをウェハー単位で形成すること。

### <マイクロバンブ事業について>

当社グループ会社である Pac Tech-Packaging Technologies GmbH(本社:Nauen Germany、CEO:Elke Zakel)は世界に先駆けシリコンウェハーのパッド電極上に UBM(Under Bump Metallization)を無電解 Ni/Au 法にてマスクレスでめっき形成するプロセスを量産レベルで確立し、当業界での確固たる地位を築いてきました。現在では、60um はんだボール搭載によるマイクロバンブ形成技術を軸に4~12インチのウェハサイズへの対応を可能にし、また、各種ウェハー(Si、裏面メタル成膜 Si、化合物半導体)にも対応、既にモバイル製品向けに量産を開始しております。

一方、当社の半導体実装開発センターではマイクロバンブを用いた三次元接合技術を開発中で、今後需要の見込まれる 50um ピッチ以下の実装技術、実装材料(封止材)およびはんだバンブ加工技術をグループ一体となって展開予定です。

従来よりご愛顧頂いております液状封止材料(LSE)製品、レジスト製品、剥離剤製品に加え、昨年フランスの Alchimer S.A.(本社:Massy France、CEO:Steve Lerner 氏)と薬液製造ライセンス契約を締結し、早期事業化を目指す TSV 穴埋め技術・材料(オールウェットプロセス、薬液)とを合わせることで高いシナジー効果を得、三次元実装技術に注力、トータルソリューションを提供、業界での当社の存在価値を高めることで事業拡販をして参ります。半導体事業において、グローバル市場で 2011 年度には 60 億円規模、数年後には 100 億円規模を目指して取り組む所存です。

今後はグループ内で、事業の一貫体制を構築し、より高いシナジー効果を発揮することで半導体市場での拡販を目指して参ります。

(参考資料)

【めっき/はんだ工程】

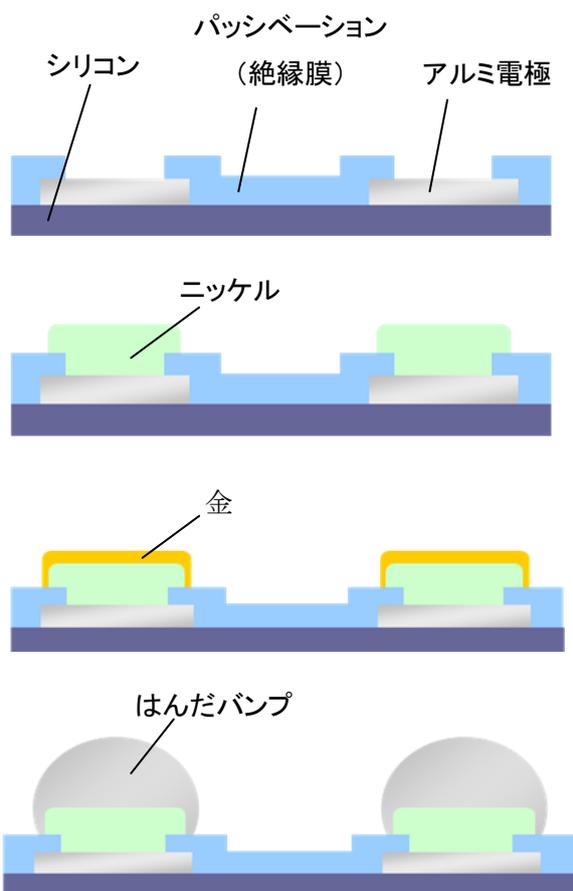
無電解Niめっき E'less Ni Deposition



無電解Auめっき Immersion Au Plating



はんだ搭載 Solder Bumping



ナガセの強み

- 短納期、マスクレス、連続自動処理の無電解めっき UBM 工法
- シリコンウェハ、裏面メタル付シリコンウェハ、化合物半導体に対応
- 個片、2~12 インチ対応
- FC 用マイクロはんだバンプ対応(100um ピッチ~)、WLP 用はんだバンプ対応(300um ピッチ~)
- Au や Cu ワイヤーボンディング下地用 UBM にも最適
- FC 用、WLP 用の液状封止材料も合わせてご紹介致します。

【長瀬産業株式会社】

設立	1917 年 12 月 9 日
本社所在地	東京都中央区日本橋小舟町 5-1
資本金	9,699 百万円
主な事業内容	化成品、合成樹脂、電子資材、化粧品、健康食品等の 輸出・輸入および国内販売
URL	<a href="http://www.nagase.co.jp/">http://www.nagase.co.jp/</a>

【本件に関するお問い合わせ先】

長瀬産業株式会社  
電子化学品事業部 半導体材料部 バンピング営業課  
電話：03-3665-3880